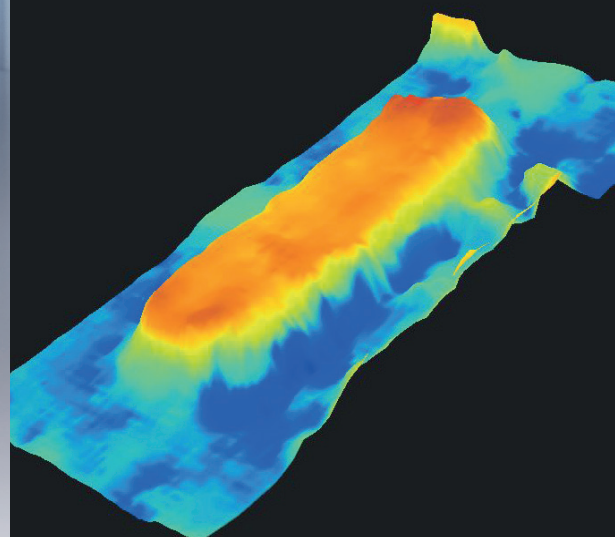




用于在线生产的
SPI (锡膏检测) 系统

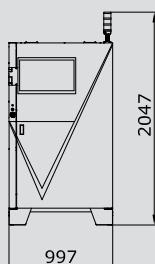


iS6052 SPI
经济型技术——
适用于锡料和烧结膏的可靠检测

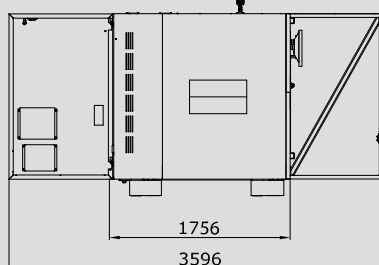
技术规格 iS6052 SPI



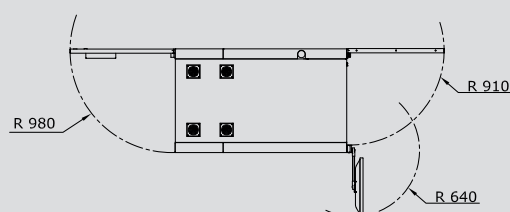
正视图



侧视图



俯视图



尺寸单位:mm

iS 6052 SPI		
检测范围		焊膏沉积 (模版印刷或点胶技术, 最大可适用于 01005 组件的焊盘); 烧结膏、黏合剂、表面、高度、印刷位移、焊膏扩散、形状、共面度、开放面积分析、OCR (光学字符识别)、DMC (数据矩阵码)
摄像头技术		XMe-SPI
	3D 传感器技术	
	Z 分辨率	0.1 μm
	Z 范围	最大 5 mm
	倾斜视角摄像头	
	百万像素摄像头数量	4
	直角摄像头	
	分辨率	12 μm
	视野范围	58 mm x 58 mm
检测速度		最大 80 cm^2/s
软件	用户界面	Viscom vVision
	统计进程控制	Viscom vSPC / SPC, 开放式接口 (可选)
	验证维修站	Viscom vVerify
	远程诊断	Viscom SRC (可选)
	编程站	Viscom PST34 (可选)
系统计算机	操作系统	Windows®
	处理器	Intel®Core™i7
PCB (印刷电路板) 处理	PCB (印刷电路板) 尺寸	508 mm x 508 mm
	PCB (印刷电路板) 支架	选配
	传送高度	900 – 950 mm $\pm$ 20 mm
	宽度调整	自动
	传送方案	单轨传送系统, 可选配双轨选项
	PCB (印刷电路板) 夹紧装置	气动
	上方通行高度	50 mm
其他系统数据	下方通行高度	50 mm; 40 mm, 包括 PCB 支架
	定位单元	同步线性电机
	接口	SMEMA、Hermes
	能源要求	230/400 V, 50 Hz, 3P/N/PE +/- 10%; 4 – 6 bar 的工作压力
	系统规格	997 mm x 1756 mm x 1753 mm (宽 x 长 x 高)
	重量	约 820 – 920 kg

规格和其它系统信息如有变更, 恕不另行通知。详情以订购时的信息为准, 可能与此处所述有所不同。